

HT-200恒温加热台平板拆焊机



技术咨询与报价

电话: 18823303057 QQ:2104028976

HT-200加热台特点

1. 采用急速升温平板加热器，可安全有效率的焊接或拆焊各式之 SMD 零件，如：SOP、SOJ、QFP、PLCC、BGA 等。
2. 具有PID温度控制系统，温度准确度可达 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ，可完全避免温度不准确而烧坏电子零件。
3. 具有时间显示装置，可设定回焊所需之时间，最长定时可定 6 分钟。
4. 可做 BGA 重植锡珠之回焊用途、单面 PCB 维修，电镀件耐温度测试、胶水加热、五金件加热等。

HT-200平板拆焊机规格参数

使用电压 (POWER)	220VAC 50/60 HZ
使用功率 (HEATER)	1000W
加热板面积 (PLATE SIZE)	200 ^L x 150 ^W mm
加热温度 (TEMP RANGE)	0~300 ^o C Max. 400 ^o C
温度精度 (TEMP PRECISION)	$\pm 1^{\circ}\text{C}$
预热时间 (START-UP TIME)	8 分钟 (20 to 200 ^o C)
机器尺寸 (DIMENSION)	280 ^L x 240 ^W x 175 ^H mm
重量 (WEIGHT)	7.5 Kg
冷却板 (COOLING BOARD)	选项